

证券代码：002916

证券简称：深南电路

### 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-14

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
<b>参与单位名称及人员姓名 (排名不分先后)</b>	易方达基金、华夏基金、南方基金、汇添富基金、鹏华基金、嘉实基金、招商基金、国泰基金、中信保诚基金、中银基金、长信基金、国寿资管、中邮人寿、泰康资管、GIC、淡水泉、华芯投资、山东国投、中航产业投资、中信证券、中银证券、国金证券、安信证券、华安证券、浙商证券、西南证券、东方财富证券、野村证券、高盛等
<b>时间</b>	2023年8月23日晚间；2023年8月24日 - 8月25日
<b>地点</b>	电话及网络会议；深南电路股份有限公司会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	副总经理、董事会秘书：张丽君；副总经理、财务负责人：楼志勇；战略发展部总监、证券事务代表：谢丹；投资者关系经理：郭家旭
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>交流主要内容：</b></p> <p><b>Q1、请介绍公司 2023 年半年度经营业绩情况。</b></p> <p>2023 年上半年，在外部环境复杂多变的情况下，整个电子信息产业受经济环境影响较为显著，行业整体需求有所承压。公司报告期内实现营业总收入 60.34 亿元，同比下滑 13.45%，归母净利润 4.74 亿元，同比下降 37.02%。上述变动主要受公司 PCB 及封装基板业务下游市场需求同比下行，叠加公司新项目建设、新工厂产能爬坡等因素共同影响。分业务来看，报告期内公司 PCB、封装基板业务营业收入及毛利率同比均有所下降；电子装联业务持续加大对下游市场的开发与深耕，叠加业务结构变化影响，营业收入同比实现增长、毛利率同比下降。</p> <p>在上半年经营承压的背景下，公司积极应对外部环境带来的挑战，通过开发新客户、强化运营提升效率、严控费用等措施降低需求弱化带来的冲击，并坚定有序推进研发工作，在封装基板高阶产品领域取得技术突破。</p>

**Q2、请介绍公司 2023 年上半年 PCB 业务在通信领域拓展情况。**

公司 PCB 业务长期深耕通信领域，覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。2023 年上半年，国内通信市场需求未出现明显改善，海外通信市场需求受到局部地区 5G 建设项目进展延缓影响，公司通信领域订单规模同比略有下降。在市场环境带来的挑战下，公司凭借行业领先的技术与高效优质的服务，在现有客户群中实现订单份额稳中有升，并持续加大力度推进新客户开发工作。

**Q3、请介绍公司 2023 年上半年 PCB 业务在数据中心领域拓展情况。**

数据中心作为公司近年来新进入并重点拓展的领域之一，已对公司营收产生较大贡献，整体市场份额有待公司进一步拓展。公司已配合客户完成 EGS 平台用 PCB 样品研发并具备批量生产能力，现已逐步进入中小批量供应阶段。公司 AI 服务器相关 PCB 产品目前占比较低，对营收贡献相对有限。2023 年上半年，由于全球经济降温和 EGS 平台切换不断推迟，数据中心整体需求依旧承压，公司该领域 PCB 订单同比有所减少。2023 年第二季度以来，数据中心领域下游部分客户项目库存有所回补，公司将继续聚焦拓展客户并积极关注和把握 EGS 平台后续逐步切换带来的机会。

**Q4、请介绍公司 2023 年上半年 PCB 业务在汽车电子领域拓展情况。**

汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一。公司以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中 ADAS 领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。2023 年上半年，公司持续加大对汽车电子市场开发力度，积极把握新能源和 ADAS 方向带来的增长机会，前期导入的新客户定点项目需求已逐步释放，同时深度开发现有客户项目贡献增量订单，南通三期工厂产能爬坡顺利推进为订单导入提供产能支撑，汽车电子领域报告期内营收规模同比继续实现增长，占 PCB 整体营收比重有所提升。

**Q5、请介绍公司 2023 年上半年封装基板业务在下游市场拓展情况。**

公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域，覆盖了包

括半导体垂直整合制造商、半导体设计商及半导体封测商等主要客户群，并与多家全球领先厂商建立了长期稳定的合作关系，在部分细分市场上拥有领先的竞争优势。目前，公司已成为内资最大的封装基板供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商。

2023 年上半年，受全球半导体景气持续低迷，下游厂商去库存等因素影响，公司各类封装基板订单较去年同期均出现不同程度下滑。公司凭借自身广泛的 BT 类封装基板产品覆盖能力，积极导入新项目，开发新客户，特别在存储类、射频模组类、FC-CSP 类产品市场取得深耕成果，把握了今年第二季度封装基板领域局部出现的需求修复机会。同时，公司在 FC-BGA 封装基板的技术研发与客户认证方面均取得阶段性进展。

**Q6、请介绍公司目前在 FC-BGA 封装基板技术研发与客户认证方面取得的进展。**

公司 FC-BGA 封装基板中阶产品目前已在客户端顺利完成认证，部分中高阶产品已进入送样阶段，高阶产品技术研发顺利进入中后期阶段，现已初步建成高阶产品样品试产能力。

**Q7、请介绍公司 2023 年上半年电子装联业务在下游市场拓展情况。**

公司电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、部分整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子等领域。2023 年上半年，公司电子装联业务加大对医疗、数据中心、汽车等领域的开发与深耕，提升客户服务水平，分别在医疗领域提升了客户粘性 & 主要大客户处份额占比、在数据中心领域稳固与客户合作关系同时改善了自身盈利能力、在汽车电子领域增加客户数量并扩大项目覆盖，叠加公司在运营层面加强项目管理能力，促进电子装联业务整体附加值持续提升。

**Q8、请介绍公司南通三期项目连线后产能爬坡进展。**

公司南通三期工厂于 2021 年第四季度连线投产，2022 年底已实现单月盈利，目前产能爬坡进展顺利，产能利用率达到五成以上。

**Q9、请介绍公司无锡基板二期工厂连线后产能爬坡进展。**

相较于常规 PCB 工厂，封装基板工厂需要构建起适应国际半导体产业链客户要求的

	<p>生产、质量、经营等高效运营体系，产能爬坡周期较长。公司无锡基板二期工厂已于 2022 年 9 月下旬连线投产并进入产能爬坡阶段，产线能力得到持续验证与提升，目前产能利用率达到三成以上。</p> <p><b>Q10、请介绍公司广州封装基板项目的建设进展。</b></p> <p>公司广州封装基板项目共分两期建设，其中项目一期厂房及配套设施建设和机电安装工程已基本完工，生产设备已陆续进厂安装，预计将于 2023 年第四季度连线投产。</p> <p>注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 8 月 26 日